Zealogics Taiwan_美商邏輯技術有限公司台灣分公司

- 履歷使用公司: Zealogics Taiwan_美商邏輯技術有限公司台灣分公司 使用人員: 黃幼綾 使用時間: 2023/05/26 14:59
- 履歷僅提供徵才目的使用·請勿違法蒐集、公開或轉其他用途;若招募作業完成請立即銷毀或刪除·以避免觸犯個資法。

2023/05/26 13:44 發出詢問意願通知 -Greeting-Amber((Sr.) C++ Developer / Image Processing影像處理 - Fully WFH)黃幼綾



徐世珉 33歳 男 代碼: 1793313439609

最高學歷 碩士畢業 中央大學 遙測科技

希望職稱 軟體工程師

總年資 8~9年工作經驗

最近工作 慧達科技股份有限公司 software engineer

居住地 220 新北市板橋區莊敬路*** E-mail victor790510@gmail.com

聯絡電話 0911-431-339

聯絡方式 (電話聯絡,09:00~21:00)

更新日: 2023/05/17 12:47

工作經歷

總年資 8~9年工作經驗

韌體設計工程師 (3~4年)、軟體設計工程師 (5~6年)

慧達科技股份有限公司 software engineer 2022/11~仍在職

產業類別 IC設計相關業

職務類別 韌體設計工程師

公司規模 30~100人

工作內容 Support isp pipeline integration

Design AWB/AIAWB Statistics CModel Refactor AWB software architecture.

台灣小米通訊有限公司 工程師 2019/09~2022/10 (3年2個月)

產業類別 消費性電子產品製造業

職務類別 韌體設計工程師

公司規模 500人以上

工作內容 Camera system (bsp)

Support integrate third party algorithm to Qualcomm platform.

Support camera related issues, CTS, ITS, performance,

Implement features on camx and chi Implement dsp for AI feature (snpe) Support for Xiaomi isp pipeline.

Support for Xiaomi AWB software Architecture design and implement.

Support for Xiaomi AIAWB

Qualcomm 工程師 2018/01~2019/09 (1年9個月)

產業類別 IC設計相關業

職務類別 軟體設計工程師

公司規模 500人以上

工作內容 iot camera software engineer

support customer for camera related features and issues.

光寶科技 資深工程師 2014/07~2017/12 (3年6個月)

產業類別 其他電子零組件相關業

職務類別 軟體設計工程師

公司規模 500人以上

教育背景

最高學歷 碩士畢業

最 高 中央大學 遙測科技 (2012/09~2014/08 畢業)

次 高 國立中央大學 大氣科學 (2008/09~2012/07 畢業)

個人資料

就業狀態 仍在職

英文姓名 Shih-Min Syu

基本資料 79年次

兵役狀況 役畢 (2017/10)

持有駕照 普通重型機車駕照、普通小型車駕照

自備車輛 普通重型機車

求職條件

工作性質 全職

希望職稱 軟體工程師

希望內容 影像處理、演算法開發等相關職務

希望職類 演算法開發工程師、軟體設計工程師、電玩程式設計師、韌體設計工程師、其他資訊專業人員

希望產業 電子資訊/軟體/半導體相關業

希望地點 台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市、基隆市

希望待遇 依公司規定

可上班日 錄取後一個月可上班

上班時段 日班、可配合輪班

語文能力

英文 聽/中等、說/中等、讀/中等、寫/中等 TOEIC (多益測驗)

台語 略懂

技能專長

專長 擅長工具

程式設計類: C、Matlab、C++、Visual C++ 辦公室應用類: Excel、Word、PowerPoint

#C #Matlab #C++ #Visual C++ #Excel #Word #PowerPoint

工作技能

韌體工程開發、軟體程式設計、韌體程式設計、文書處理軟體操作、電子試算表軟體操作、簡報軟體操作、流程圖軟 體操作

#韌體工程開發 #軟體程式設計 #韌體程式設計 #文書處理軟體操作 #電子試算表軟體操作 #簡報軟體操作 #流程圖軟 體操作

其他工作技能

影像處理、相機模組校正、3A、OpenCV、I2C、Image Processing、Camera Calibration、MFC、 Camera driver, Android camera HAL.

認證資格 英語相關證照:TOEIC (多益測驗)

自傳

[求學階段]

研究所時期就讀於中央大學遙測科技學程,因為對於影像處理有興趣,因此進入了『圖形模式運算實驗室』。碩士研究項目為利用多頻段的衛星影像進行影像分類,因為研究項目需求,分別選修了數位訊號處理、圖形識別、偵測與估計等相關課程,無論是機器學習、分類、辨識等方面,對於碩士研究都提供了非常大的幫助。

研究為使用高光譜影像進行影像分類·利用數學的方式將pixel內的成分進行分解·推估此pixel中·各物質所佔的比例。

[工作階段]

Qualcomm, Engineer

在高通擔任IoT Camera SW engineer

協助廠商解決Camera SW相關的問題

- 1. Camera Sensor driver porting
- 2. CTS/VTS debug
- 3. Camera HAL: CamX, Chi node

Liteon, Senior Engineer

畢業後,在光寶科技相機模組部門(PID)擔任韌體開發工程師,主要負責模組生產與校正的程式開發與協助處理產線不良率與客訴問題。

- 1. 使用Visual Studio C++ + OpenCV 開發
- 2. 相機模組3A、PDAF、driverIC控制、OIS、Dual cam等校正程式開發
- 3. 產線測試程式開發
- 4. 協助產線提升生產良率
- 5. 需要與其他單位EE, ME與廠商等一起合作
- 6. 協助處理客訴與不良分析
- 7. DLL開發與維護

[未來展望]

對於工作上的困難,會主動學習新的技能去解決問題,積極的尋找新的辦法,努力達成目標。學習上,隨著技術的日新月異,會學習新的事物來充實自我。

附件

研究所成績單 下載檔案

大學成績單 下載檔案

論文摘要 下載檔案